

◆薬品売上高が軟調に推移

社長 前田 和夫

当期のトピックスは、為替については、米ドルは想定レート 109 円に対し実勢レート 110.48 円（前年 108.83 円）、台湾ドルは 3.66 円に対し 3.58 円（前年 3.70 円）、中国元は 16.85 円に対し 16.38 円（前年 17.10 円）であった。為替の影響は売上高で前年同期比 50 百万円減、営業利益は 27 百万円減となった。

薬品は全てのセクターが軟調に推移し、売上高 13.2%減、出荷量 11.6%減となった。

当期の業績は、売上高 23 億 28 百万円（前年同期比 12.5%減）、営業利益 2 億 5 百万円（同 60.5%減）、経常利益 2 億 40 百万円（同 53.0%減）、純利益 1 億 58 百万円（同 56.6%減）となった。薬品売上高は 22 億 66 百万円で、売上高に占める割合は 97.3%（同 0.9 ポイント減）である。海外売上高比率は、54.9%であった。

CZシリーズの売上高は 11 億 85 百万円で、薬品売上高に占める割合は 52.3%（同 0.7 ポイント減）となった。粗利益率は売上減少や為替の影響などにより 59.4%（同 4.1 ポイント減）となった。当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に計算した場合の比率は 71.6%（前年同期 73.9%）である。

◆2019年12月期第1四半期決算概要

常務執行役員管理本部長 北村 伸二

売上高は 23 億 28 百万円（前年同期比 3 億 32 百万円減）、薬品は 22 億 66 百万円（同 3 億 46 百万円減）、機械は 40 百万円（同 31 百万円増）、資材は 15 百万円（同 6 百万円減）となった。売上総利益減少の要因は、売上減少や為替の影響などによるものだ。営業利益は 2 億 5 百万円（同 3 億 14 百万円減）、経常利益は 9 月に発生した台風被害に対する受取保険金 20 百万円などにより 2 億 40 百万円（同 2 億 70 百万円減）、四半期純利益は 1 億 58 百万円（同 2 億 7 百万円減）となった。

連結貸借対照表については、資産の部では、流動資産は 88 億 53 百万円（前期末比 2 億 94 百万円減）となった。固定資産は、建設仮勘定が主にタイの事務所・工場建設により 1 億 59 百万円増加した。投資その他の資産は投資有価証券の時価上昇などにより 10 億 76 百万円（同 55 百万円増）となった。負債は、尼崎事業所建設資金として、20 億円の借入れに対し 12 億 50 百万円返済している。

株主資本は、利益剰余金が 146 億 38 百万円（前期末比 1 億 9 百万円減）となり、その結果、負債・純資産合計は 185 億 8 百万円（同 92 百万円減）となった。純資産は 151 億 32 百万円（同 33 百万円減）、自己資本比率は 81.8%となった。

売上高は 23 億 28 百万円（前期比 3 億 32 百万円減）で、減収の要因（前年同期比）は、密着向上剤、エッチング剤、その他薬品、全てが減少した。営業利益は、生産数量減少による原価上昇や為替の影響などにより 2 億 5 百万円（同 3 億 14 百万円減）となった。

売上高の四半期推移は、2018 年 1～3 月期は仮想通貨関連により好調だった。当社の場合 1～3 月期は季節要因もあり弱い傾向にある。営業利益の四半期推移は、粗利益率の低下や台風被害による修繕費、共同研究費、分析機器リース費等により減益となった。

品種別売上四半期推移では、機械売上高は増加し、薬品、資材、その他は減少した。薬品別四半期推移は、ほぼすべての薬品の数量、売上が減少となった。主力製品の C Z シリーズは、パッケージ関係需要の減少により数量、売上が減少した。

地域セグメント別売上高推移と海外比率は、全地域で減少した。

2019 年 12 月期連結業績予想は変更せず、売上高 118 億円、営業利益 20 億 50 百万円、経常利益 21 億円、純利益 15 億円としている。今期の研究開発費は 12 億 80 百万円、設備投資額は 19 億 57 百万円を計画している。配当は 26 円、連結配当性向は 32.9%の予想である。

◆今後の事業展開

社長 前田 和夫

一部で 5G 対応のスマートフォンが出ている。それに対応して 5G 用の基板はこれから少しずつ量産に入り、2020 年の春先に向けてある程度の量をつくると考えている。これらが動くことで、メモリ向け基板が回復するだろう。自動車向け基板も 2019 年後半に期待できると考えている。

今後、電子基板の需要はサーバー等が牽引するだろう。具体的にはサーバー向けの PKG 基板の高密度化がさらに進むと考えている。また、5G 用スマートフォンに関しても、一番特徴的な変化がアンテナモジュールで、5G の高周波の特性からできるだけアンテナを数、多方向に向けてつけることが必要になってくるため期待している。今後もサーバー、スマートフォン等の高密度基板に当社の CZ シリーズ、V ボンドシリーズ、EXE シリーズ、UT シリーズの重要性が高まるとみている。

CZ シリーズの進化版 CZ-8401 を開発しており、0.1 μm のエッチングでも密着力を強化できる薬品である。既存の CZ シリーズと同等の密着強度を出しながら高周波向け基板に対応できるプロセスを開発している。

資本政策として ROE は 10% をベースに持続的改善を、また株主還元として連結配当性向 30% を中期的な目標としている。今後さらなる成長のための投資として、連結売上高約 10% 以上を研究開発費に先行投資していく引き続き実行していく。

◆質疑応答◆

1～3 月の決算で特に悪かったものは

半導体のパッケージ、車向け基板の減少、スマートフォンも時期的に需要が冷え込む時期であり、それらすべてが重なったのが 2019 年 1～3 月期だと考えている。

今後の回復の展望の根拠は

5G 用サーバーやスマートフォンのパッケージ基板、テレビ、スマートフォン向けの COF、マザーボード向けが増えてくると考えている。

CZ-8401 プロセスの付加価値は

既存の CZ シリーズの約 1/10 のエッチング量でありながら、同等の密着強度を満たすことができる。また、伝送損失を少なくできる高周波対応の部分でお使いいただけるというところが大きなメリットだと考えている。

FlatBOND と CZ-8401 の差異は

FlatBOND は基地局などで使われる大きい基板等で実績を積み上げている。一方 CZ-8401 は半導体パッケージ用としての開発、発展させている。

開発に関しては FlatBOND（粗化しない薬品）も継続し、次の世代にも対応できる体制を整えている。

通期計画の想定は

米中貿易戦争など不透明であるが 2019 年後半には 5G 向けやスマートフォン向けが回復すると考えている。

タイでの製造薬品について

需要が見込まれる全ての薬品に対応できるようにしている。

(2019 年 5 月 13 日・東京)

* 説明会資料は以下の URL からご覧になれます。

<https://www.mec-co.com/ir/library/>